

证券代码：002618

证券简称：丹邦科技

公告编号：2017-006

## 深圳丹邦科技股份有限公司

# 关于国家科技重大专项（02 专项）“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”项目通过正式验收的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 4 月 13 日，国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（02 专项）实施管理办公室会同总体组在广东东莞组织召开了“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”（项目编号 2011ZX02710）项目正式验收会。

“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”（项目编号 2011ZX02710）项目由深圳丹邦科技股份有限公司全资子公司广东丹邦科技有限公司承担，并与课题单位中国科学院微电子研究所及深圳市新宇腾跃电子有限公司合作完成。

本项目历经专家组多次实地检查、现场测试、资料审查、内部验收及正式验收前的现场复查等系列检查后进入正式验收，与会专家听取了承担单位的项目完成情况报告和现场测试组的正式验收测试报告，审阅了验收资料、进行了正式验收现场考察，经过质询、讨论和逐项打分，认为本项目已经完成了合同书中约定的各项考核指标，验收专家组一致同意项目通过正式验收。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 14 日